

生益电子股份有限公司

关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案 的年度评估报告

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

报告期内，公司按照行动方案有力有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运营管理、公司治理等多方面持续发力，实施情况和实施效果主要如下：

一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局

报告期内，公司聚焦主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建了高精度 HDI 产线及软硬结合板产线，优化产品布局，覆盖更多领域产品，进一步增强公司竞争力。

在通讯领域，公司凭借敏锐市场洞察力，合理调整发展策略，推动通讯板块稳健发展。2024 年，聚焦高端研发，积极寻找机会与头部企业合作，在高端交换机等领域取得突破，目前相关产品已经完成多家战略合作客户的认可。同期，在卫星通讯领域也取得了积极进展，相关产品已完成前期研发与测试工作，为公司在该领域的市场拓展奠定坚实基础。

在计算机及服务器领域，公司积极携手多家知名服务器企业，展开深度合作。凭借在高端产品加工领域积累的深厚经验，公司对服务器产品进行了全方位、多层次的优化升级。本年度，公司服务器产品销售占比大幅提升，相关市场份额也大幅提升，为公司业绩实现大幅增长提供了强劲动力与坚实支撑。

在汽车电子领域，公司凭借在汽车电子领域所积累的技术实力与行业经验，进一步深化与国内外知名厂商的合作开发。目前，公司在智能辅助驾驶、动力能源以及智

能座舱等核心产品线的批量订单正在稳步推进中。本年度，公司的汽车电子产品销量继续增长，保持了稳步提升。

二、持续加强研发投入，保持技术领先优势

公司目前拥有 PCB 产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经获得了 276 项发明专利（含 1 项美国发明专利），主要参与及参与制定了 20 项行业标准及规范。报告期内，公司持续加大对核心技术的深度研究和布局，新获得国内发明专利 32 项、新主要参与及参与制定发布标准 4 项、新发表技术论文 11 篇，以持续提升的核心竞争力，维护公司在行业内的技术领先地位。

报告期内，公司持续加强研发投入，在行动方案中 8 个研发项目有序开展的基础上，新增 7 个研发项目，聚焦网络、卫星通讯、无线通讯、消费电子、高端服务器、智能汽车电子、新能源等领域的相关技术研发，以保持公司技术领先的优势。主要项目及其开展情况详见下表：

序号	项目名称	应用领域	研发目标	研发进展
1	高密组装 高端印制 电路板的技术 研究开发	网络领域 服务器领域	研究开发双面阶梯图形（含阶梯金手指）、逐次压合 HDI 结构+阶梯槽图形等各种结构的三维组装，复杂结构的高端高密线卡板，提升公司在图形计算、高速网络服务器等高端线路板领域的竞争力，并实现产业化。	完成项目开发以及工艺技术的转化，已批量应用在高密组装高端产品上，显著提升公司在图形计算、高速网络服务器等高端产品领域的技术能力水平。
2	400G 及以上 高端光模块印制 电路板的研究开发	网络领域 服务器领域	研究开发面向电信光通讯网络及数据中心架构网络应用的 400G 及以上传输速率的高速光模块印制电路板产品，攻克 HDI 复合光器件异形结构设计、精细 Wire Bonding 图形及金手指精密加工等技术难点，并实现产业化。	已实现 QSFP-DD 及 OSFP 封装类型 400G 以上高速光模块量产，具备 3/3mil COB 精密图形、高阶 HDI 局部阶梯槽/埋铜/软硬结合高速光模块量产供应及 Anylayer 结构光模块样板制作能力。
3	面向车载 毫米波雷达的印制 电路板的研究开发	汽车领域	研究开发面向车载毫米波雷达的印制电路板产品，提升公司在汽车智能驾驶领域的市场竞争力，并实现产业化。	完成对毫米波雷达主流技术的分析和研究；完成主流高频材料的层压和钻孔加工参数研究；完成毫米波雷达制作流程、天线精度的优化改善。汽车毫米波雷达产品具备量产能力。

4	nR-nF-nR 特殊结构高多层软硬结合板工艺的研究开发	网络领域 服务器领域 消费电子领域	研究高阶 HDI 埋铜块、局部盖子保护、点胶、贴屏蔽膜、air-gap 等特殊结构高多层软硬结合板制作技术，攻克不对称结构翘曲、高多层软硬结合板可靠性等技术难关，并实现产业化。	开发出复合高阶 HDI 埋铜块、局部盖子保护、点胶、贴屏蔽膜、不对称结构、air-gap 等特殊结构的高多层软硬结合板制作工艺，解决了不对称结构翘曲、高多层软硬结合板可靠性等技术障碍，已实现批量生产。
5	EGS 服务器高可靠性印制电路板的研究开发	服务器领域	研究开发高性能（损耗要求 $<0.96@16\text{GHz}$ ）、低成本的材料应用于 EGS 平台产品的新技术，可靠性、BGA 平整度、翘曲等均能满足产品要求，提升公司在高端服务器领域的市场竞争力，并实现产业化。	已顺利完成 EGS 服务器主板平台各类考试板和 NPI 板的制作，相关技术得到积极推广应用。
6	面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 的研究开发	汽车领域	研究不同材料 1500V 高压 CAF 的 PCB 制作工艺及失效模式潜在影响，完成面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 产品的研制，并实现产业化，提升公司在车载高压平台 PCB 制作方面的市场竞争力。	完成既定材料在 1500V 高压下 CAF 测试及失效分析，以及在 1500V 高压下 CAF 测试的性能差异。具备该类产品的批量生产能力，400V 平台项目相关开发已完成并实现量产，在智能座舱 LGA 项目已实现量产。
7	面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板的研究开发	新能源领域	研究开发面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板产品，提升公司在光伏新能源领域的市场竞争力，并实现产业化。	通过实验优化设计和叠层已完成厚铜能源耐高压产品的长期耐高压测试；已达成厚铜能源产品长期耐高压的水平。
8	高密精细线路高阶互联印制电路板的研究开发	消费电子领域 汽车领域	实现 anylayer HDI 高密互联产品结构设计的制作，具备各层 0.35mm pitch BGA 夹横竖绕线的精细线路制作能力，提升我司在消费类产品及可穿戴等产品上竞争优势，并实现产业化。	实现 anylayer HDI 高密互联产品结构设计的制作，具备各层 $40\mu\text{m}/40\mu\text{m}$ 的精细线路制作能力，提升我司在消费类产品及可穿戴等产品上竞争优势，并实现产业化。
9	应用于卫星互联网的印制电路板的研究开发	网络领域 卫星通讯领域	研究卫星互连星载 PCB 技术，提升公司在星地互连网络领域技术开发能力，提升在卫星通讯领域的竞争力，并实现产业化。	完成互连星载 PCB 技术中的高多层高频材料压合技术研究，正在研究低密度高频材料混压减重技术。

10	车载 800V 高压系统平台 PCB 的研究开发	汽车领域	研究开发面向车载 800V 高压系统平台的印制电路板产品，提升公司在新能源汽车领域的市场竞争力，并实现产业化。	已完成第一阶段不同板材、不同叠构、不同设计在高电压（1000V/1500V）条件下的长期可靠性的相关研究。
11	下一代网络技术 1.6T 以太网主板的研究开发	网络领域 服务器领域	研究对高速信号传输、信号完整性、可加工性、可靠性超高要求的印制电路板产品，抢占下一代 1.6T 以太网产品市场、确保我司长期在核心网络主板加工的技术优势。	完成 1.6T 以太网主板 SI 性能研究；完成新构建的 1.6T 容量即单通道 224G 通孔过孔方案测试模型研究；完成 1.6T 以太网主板 PCB 各关键指标的仿真、分解和能力提升研究。
12	Power Next 高端服务器印制电路主板的研究开发	服务器领域	研究开发 Power Next 高端服务器高可靠性印制电路板产品，促使高端服务器的国产化，并实现产业化。	完成材料评估选择及实施方案策划，同步完成国产化材料组合方案试板加工制作。
13	5.5G 无线通信产品的研究开发	通讯领域 消费电子领域	研究开发 5.5G 无线通信印制电路板产品，攻克技术难点，并实现产业化。	1. Mid loss/low loss low CTE 板材多区域埋铜混压技术：已开发 4 种板材，适用多区域埋铜块混压工艺，满足可靠性及焊接稳定性需求。 2. 大尺寸埋铜块密集排板工艺技术：已通过板材选择、叠构搭配及层压参数等方面研究，解决小间距埋铜块介厚不均及可靠性难点。 3. 大尺寸 AAU 稳定性技术：完成板材选用、层压参数及缓冲材料替换方案阶段性研究。
14	面向超级计算机主板的印制电路板的研究开发	网络领域 消费电子领域	研究开发面向超级计算机主板的印制电路板，满足更严苛的翘曲度与平整度要求，并实现产业化。	完成超级计算机主板开发的前期预研工作，已完成叠构设计更新，正在验证翘曲及平整度。
15	应用于云服务超算的高端 AI 服务器的研究开发	服务器领域	研究开发应用于云服务器超算的高端 AI 服务器的高端印制电路板，并实现产业化。	已完成超高层大尺寸厚板电镀深镀能力、图形精度、平整度、插损等技术能力研究，输出了可行的加工工艺方法，具备 NPI 生产的能力。

三、深化组织运营管理，提升综合竞争力

1、建立健全人力资源政策，激发组织与员工活性

基于外部形势、行业竞争以及公司发展需求，报告期内，公司持续推进人力资源政策的建立健全，激发组织活性与员工活力。

在激励与约束方面，公司通过目标管理牵引促进人效提升，并完善了相应的激励机制与制度，在此基础上对公司薪酬结构进行变革优化，加强了薪酬与个人绩效的关联，以强化薪酬激励作用；同时，公司进一步完善了绩效管理制度，通过强绩效管理引导员工发挥自身价值、创造价值，提升员工的积极性和获得感。此外，完善了干部管理制度，开展了全面的 360 度调研，明确了干部管理的新要求，推动了干部履职能力的提升。

在组织队伍建设方面，公司持续完善培训与发展体系，重视后备人才的培养和发展，通过金牌班组长助力基层管理者实现管理能力升级，重点开展匠星计划，推动泰国项目、英语培训、车载项目、体系项目等培训专项落地，持续提升员工专业能力，助力业务成功。同时，完成了全公司人才盘点，通过识别各岗位人才类型，构建人才盘点九宫格模型，依据模型梳理公司人才梯队建设现状及人才发展路径，针对性地为各类人才采取相应规划措施，提高人才规划的精确度。

在文化建设方面，持续深化了文化内核，打造了文化品牌，开展了“点赞”活动，举办了技能大赛、子女托管班等活动，提升员工对公司的认同感和归属感，营造了良好的工作氛围，增强团队凝聚力。

2、建立充分竞争的商务环境，保证采购安全和推动成本节省

公司不断深化和完善供应链管理体系，通过采用机器人流程自动化技术，实现了采购计划的自动化，同时利用 SRM 供应商管理系统，加强了与客户的内外部协同，赋能供应商，构建了一个集成、精益、多元化的供应链体系。在此过程中，公司集中各子公司的需求并统一议价，充分发挥集中采购的优势，有效降低成本并提高效率。报告期内，公司在全球合作供应商约 800 家，其中超过 95%来自国内，关键物料认可多家供应商，确保供应安全。公司持续与核心供应商保持战略合作关系，报告期内，公司组织供应商开展超过 2000 人次的培训及技术、质量相关交流，已开展约 60 次的供应商现场审核与交流，已导入约 14 项新物料，进一步保障供应链安全，建立充分竞争的环境，为降本增效保驾护航。

3、提升自动化和智能化水平，提高生产运营效率

公司坚持“聚焦重点、提升效能”的策略，以数智驱动企业转型升级，提升产品创新与管理能力。

报告期内，各项自动化、数字化、智能化重点项目均按计划顺利推进，其中：

使用内存数据库技术，依托数据仓库和商业智能 BI，成功构建 PCS 级产品追溯平台，通过制造大数据分析为质量管理数字化提供有力支持。自动智能排产平台顺利推广，东城三厂全部核心流程上线，并应用到其他工厂，实现各工序智能协同作业和智能调度，显著提升工厂制造自动化和智能化水平。与多家大模型 AI 厂商进行深入交流及探索验证，引入生成式 AI 工具，并通过多种方式提升内部用户的数字素养和 AI 使用能力。引入机器人流程自动化工具，并作为重点项目成功实施，按计划顺利完成 22 个流程的开发及上线运行，实现工作质量和效率的明显提升。

公司在智能制造和数字化转型的努力已经取得显著成效，公司将继续加大投入，深化数字化建设，完善现有项目，并探索新的技术应用，以实现更高效、更智能的运作，持续提升生产运营效率。

4、进一步强化质量管理，保证公司产品质量竞争力

报告期内，公司持续强化“零缺陷”管理，进一步优化并推进零次废员工及质量优胜奖管理评审和监督机制，持续强化员工一次做对的理念。同时各工厂全员推进 QCC 小组及工序 OEE 活动开展，推动全工序零缺陷项目有效落地，提升工厂整体质量管理水平，公司内外部主要质量指标均较上一年度有所改善。

在推进质量管理机制落地方面，质量中心定期组织质量会及质量案例研讨与交流，梳理改善重点，评估改善效果。通过组织集团质量研讨会议，有效指引各工厂开展相应的质量管理活动。同时，公司持续推进举手机制、质量红线机制以及质量管理闭环监督机制的有效落地，组织集团质量基础知识测试与质量月活动的开展，组织工厂质量一致性的对标与提升，推动全员参与质量改善，提升质量意识和质量效益。

在推进质量改善专项与质量平台建设方面，在严进、过程管控、严出、客户服务等方面加强管理。严进方面，持续优化来料检验方法与标准，提升检验手段，利用管理 IT 化不断推动供方质量提升与内部质量稳定，严把供方质量绩效管理。过程管控方面，持续推动工厂 PCS 级追溯管理平台以及质量自主预警平台的搭建与推广应用，进一步精准识别和控制风险；推动 SPC 项目的有效开展，提升过程质量稳定性；组织梳理各工厂各流程防呆防错机制对标与系统化；建立客户 SPEC 要求模块化与应用，

建立检验要求下发系统，推动客户要求在各工序的有效识别与监控；持续梳理优化工厂主要业务流程，提升工作质量与效率。严出方面，重点推动各工厂质量检验有效性提升，建立完善质量检验地图规范；持续跟进高风险缺陷的机理研究与问题解决及系统防呆。

报告期内，公司质量表现稳步提升，获得多家关键客户颁发的“最佳质量奖”“最佳综合绩效奖”“合作共赢奖”“优秀供应商”等奖项。

四、聚焦公司重大项目，有力有序推进项目实施

1、有力推进东城四期项目，提升盈利能力

东城四期项目是公司实现产品和技术升级的重要举措，报告期内，东城四期项目（东城三四厂）结合自身工厂定位，充分发挥智能化工厂的优势，实现了产量和产值的稳步上升。东城四期三厂以客户满意为导向，抓质量、保交付，顺利完成客户考试板的交付，并通过了所有计划内的重要客户审核认证，赢得了客户的广泛认可，获得了高附加值的高阶 HDI 量产订单。东城四期四厂全年产量逐步爬坡提升，产值稳步增长。报告期内，东城四期项目已实现季度连续盈利，利润保持稳定增长。

2、稳步推进吉安二期项目，充分评估和控制投资风险

报告期内，公司结合市场形势、产能规模以及募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整，从原计划2024年6月调整至2025年12月。目前吉安二期项目厂房基建部分已进入收尾阶段，后续公司将积极分析市场需求和发展情况，根据发展战略，分析和规划吉安二期项目的产品定位与结构，适时投入运营。



3、系统布局泰国新建生产基地项目，推动项目启动建设

报告期内，公司综合海外战略、行业发展、客户需求等多方因素，组建了泰国生益筹建团队，进一步完善公司在泰国新建生产基地的具体安排，主要完成了工厂设计规划、土建选型、合规性制度建设以及内部制度建设及资源保障等工作。项目于 2024 年 11 月正式动工，项目建设期 1.6 年，产能爬坡期 2.0 年，预计于 2026 年开始试生产。

五、持续完善公司治理，推动公司高质量发展

1、深入贯彻落实独立董事制度改革

公司有序落实独立董事制度改革，修订了《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》等相关制度，并严格按照相关制度要求执行。公司已为独立董事们开设专属办公室，便于独立董事开展现场工作，并指定了董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责组织交流、会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事工作提供便利条件，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2、持续深化内部审计工作

报告期内，审计部结合年度审计计划及公司实际业务发展需求，有效完成了每季度的募集资金使用情况审计、公司及子公司吉安生益 2023 年进出口业务及海关 AEO 高级认证企业标准符合情况审计、东城四期及研发中心工程及设备固定资产管理情况审计、生产循环审计及生产制造系统管理人员任中审计、公司及香港子公司销售及收款业务审计、研究与开发审计、采购与付款审计、人力资源审计、固定资产投资后评价、关联交易及安全生产的专项审计。

经审计评估，公司整体内控制度在设计和执行层面是合理有效的，未发现重大内控缺陷。确认公司不存在募集资金管理的违规情形；关联交易公平公正、价格公允合理，有效维护股东及公司合法权益；公司整体安全管理状况良好；2023 年新增的固定资产较好地达成了投资预算目标；同时，审计部对细节管理方面提出了改善建议，并督促相关业务单位结合自身实际情况制定改善计划，和及时、有效地完成改善。有效促进了吉安生益顺利获得海关 AEO 高级认证和公司 AEO 高级认证的复审；促进重大投资项目管理持续优化。通过采购和销售业务的审计，确保流程合规和风险的有效管控。

六、加强投资者沟通交流，完善投资者意见征询与反馈

报告期内，公司积极接听投资者专线，及时回复“上证 E 互动”平台以及投资者交流邮箱上投资者关注的问题，在定期报告后以视频+文字互动的形式举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“上证路演中心”以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示，在“生益电子”公众号上发布一图读懂年报、一图读懂社会责任报告，在生益电子官网设置投资者关系专栏，并下设股东回报、最新公告、财务数据、公司研报、公司调研五个专项，方便投资者以各种渠道了解公司。同时，报告期内，董事长、董事、独立董事与高管组织召开 3 场业绩说明会和 2 场投资者集体交流会，和投资者充分沟通交流，传递公司经营理念和价值。

七、完善投资回报机制，启动实施股份回购

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际回购公司股份 15,518,757 股，占公司总股本 831,821,175 股的比例为 1.87%，回购成交的最高价为 10.80 元/股，最低价为 8.52 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 149,972,150.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司完成回购事项。

根据回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。公司将在相关公告披露后三年内按照本次回购股份的用途实施。如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本，公司总股本将相应减少，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

八、强化管理层与股东利益的共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、强化高级管理人员激励及约束

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《生益电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司的发展阶段，制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。围绕《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司中期发展战略、2024 年重点工作以及行业情况等制定高级管理人员 2024 年绩效考核指标，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

展。

高级管理人员 2024 年绩效考核设置了资产收益率、销售收入、核心客户开发进度完成率、技术创新、成本、人效等指标。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司启动了 2024 年限制性股票激励计划，方案设置了有挑战性的业绩目标和约束条件，有助于激发核心人员活力，促进核心人员稳定，推动公司实现更高质量的发展。

2、控股股东自愿延期解禁

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东生益科技股份有限公司关于自愿延期解禁限售股的说明。控股股东认为，公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业优质客户。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。公司在建项目多且进展良好，未来几年将陆续投产，新项目投产后，行业地位将明显提升，行业影响力将明显增强。基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东决定延期解禁所持全部限售股 6 个月，报告期内上述股份已经解除限售。

3、部分股东自愿承诺未来六个月不减持公司股份

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司关于自愿承诺未来六个月不减持公司股份的说明。公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，上述股东自愿承诺，自承诺函签署之日起 6 个月内（2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日）不减持其所持有的公司股份。

报告期内，上述股东严格履行自愿承诺内容，承诺期限内未减持公司股份。

4、5%以上股东国弘投资增持公司股份

公司于 2023 年 10 月 27 日收到公司持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司的告知函，东莞市国弘投资有限公司拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所允许的方式，增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元，资金来源为国弘投资自有资金和自筹资金。自增持计划披露之日起，截至 2024 年 4 月 29 日，国弘投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,814,666 股，占公司总股本的 0.22%，合计增持金额约为人民币 2,068 万元，本次增持计划已实施完毕。

九、其他事宜

报告期内，公司按照行动方案细化深化工作举措，相关工作有序推进落实，公司实现营业收入 46.87 亿元，同比增加 43.19%，实现净利润 3.32 亿元，实现扭亏为盈。

2025 年，公司将在 2024 年行动举措的基础上继续明确“提质增效重回报”行动方案，及时履行信息披露义务。公司将继续专注印制电路板主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

生益电子股份有限公司

2025 年 3 月 28 日